

MEMORIAL DESCRITIVO

MODELO: Grind Machine PLC

NCM: 8537.10.90

DESCRIÇÃO: Painel de controle com CLP (Controlador Lógico Programável) responsáveis pelo gerenciamento, controle e monitoramento de parâmetros operacionais da máquina.

Características:

O Grind Machine PLC é um painel de controle com CLP (Controlador Lógico Programável) utilizados no processo de retifica de esferas responsáveis pelo gerenciamento, controle e monitoramento de parâmetros operacionais da máquina. É composto por CLP, interface homem-máquina (IHM) com tela sensível ao toque, servomotor, inversores de frequência e módulos de entrada/saída digitais e analógicos. Painel de controle parametrizado para o processo de retifica de esferas. Painel de controle parametrizado para o processo de desbaste de esferas. A alimentação elétrica é trifásica, com proteção contra sobrecargas e picos de tensão. Os painéis são montados em estrutura metálica adequado ao ambiente industrial; Dimensões (mm): 1650x650x800;

APLICAÇÃO: Controle de máquinas de retifica de esferas, com monitoramento de parâmetros de processo e acionamento preciso via servomotor, garantindo eficiência energética, estabilidade dimensional e qualidade do produto final.

Foto do equipamento:

